

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

1. 截至民國一一二年九月三十日止，本公司及子公司已開立但未使用信用狀之金額約為 6 億元。
2. 截至民國一一二年九月三十日止，本公司及子公司主因訴訟、購電及海關稅捐等保證委請金融機構開立之履約保證之金額約為 24 億元。
3. 以本公司及子公司名義簽訂技術授權及智權開發合約之總價款約為 36 億元，截至民國一一二年九月三十日止，尚未認列金額約為 13 億元。
4. 本公司及子公司因營運所需而簽訂之工程合約總價款約為 789 億元，截至民國一一二年九月三十日止，尚未認列金額約為 502 億元。
5. 本公司及子公司與部分客戶簽訂晶圓代工合約，依合約之規定，提供特定產能予該等客戶。
6. 本公司董事會於民國一〇三年十月九日通過決議，與廈門市人民政府及福建省電子信息集團簽訂參股協議書。依協議書約定，本公司與福建省電子信息集團合資成立之公司於福建省廈門市從事半導體製造，提供 12 吋晶圓專工服務。本公司及子公司依此協議於民國一〇四年一月至一〇七年九月經主管機關審查通過分期注資聯芯集成電路製造(廈門)有限公司(以下簡稱聯芯)人民幣 82.8 億元，並取得控制力。另，依參股協議規定，於其餘出資方之出資額全數到位後第 7 年(民國一一一年)開始以加計固定收益方式買回其出資份額總計人民幣 48.6 億。因此，本公司根據國際財務報導準則第 10 號規定於財務報導期間內認列非控制權益。並根據 IFRS 9 規定於每一報導期間結束日，將對其他出資方之承諾認列為金融負債，同時沖減非控制權益，差額認列於權益項下。

本公司董事會於民國一一一年四月二十七日決議，本公司擬透過薩摩亞子公司 GREEN EARTH LIMITED 轉增資開曼群島子公司 UNITED MICROCHIP CORPORATION 以人民幣 41.2 億元或等值美金(約美金 6.6 億元)，向廈門金圓產業發展有限公司取得其對聯芯之出資；另由子公司和艦芯片製造(蘇州)(股)公司以人民幣 7.4 億元或等值美金(約美金 1.2 億元)，向福建省電子信息產業創業投資合夥企業(有限合夥)取得其對聯芯之出資；合計投資金額人民幣 48.6 億元。前述交易已於民國一一二年七月全數一次完成。

7. 臺灣臺中地方法院檢察署於民國一〇六年八月三十一日以本公司之受雇人涉嫌侵害 MICRON TECHNOLOGY, INC. (MICRON 公司)及臺灣美光記憶體之營業秘密為由，依營業秘密法對本公司提起公訴，民國一〇九年六月十二日臺灣臺中地方法院就本公司等人被控告竊取營業秘密案作出有罪判決，本公司依法提起上訴。民國一一〇年十一月二十六日本公司與 MICRON 公司簽訂達成全球性和解之協議，爾後 MICRON 公司已遞交書狀表示撤回告訴。民國一一一年一月二十七日，上訴法院就本案作出判決，本公司被判處新臺幣 2 仟萬元罰金，緩刑貳年。